

1. はじめに

1.1 目的

本試験は、PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH の設計目標書 108-78454-1 Rev. B に規定された性能必要条件に合致しているか確認するために行われた。

1.2 適用範囲

本報告書は PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH の電氣的、機械的及び環境的性能必要条件について行った試験内容を記述している。

本製品確認試験は 2008 年 8 月 1 日から 2008 年 10 月 20 日までに行われた。

1.3 結論

PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH は該当の設計目標書 108-78454 Rev. A に規定された性能必要条件に合致していた。

1.4 製品の説明

PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH は、ISO 7816-2 に準じた Subscriber Identity Module(SIM)カードと携帯電話の基板を繋ぐものである。

1. Introduction

1.1 Objective

Testing was performed on the PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH to determine if it meets the requirements of Design Objective, 108-78454, Rev. A.

1.2 Scope

This report covers the electrical, mechanical and environmental performance requirements of the PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH.

The qualification testing was performed between 01 AUG 2008 and 20 OCT 2008.

1.3 Conclusion

The PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH meets the electrical, mechanical and environmental performance requirements of Product Specification, 108-78612, Rev. A.

1.4 Product Description

The PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH is designed to make a connection between a Subscriber Identity Module (SIM) according to ISO 7816-2 and a printed circuit board.

1.5 試料

試料は 2008 年 6 月に行った機能試作品の評価である。以下の試料が試験に使用された。

1.5 Test Samples

Samples were taken from 1st proto sample for test. The following samples were used:

型番 Part Number	品名 Description
1981959-1	PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH
1981959-2	PUSH PUSH SIM H1.87 WITH SWITCH WIDE WINDOW

Fig. 1

2. 試験内容

2. Test Contents

項番 No.	試験項目 Test Items	必要条件 Requirements	判定 Judgment
2.1	製品の確認 Examination of Product	目視により、コネクタの機能上支障をきたす損傷なきこと。 Visual Inspection No physical damage	合格 Acceptable
電 気 的 性 能 Electrical Requirements			
2.2	総合抵抗 (ローレベル) Contact Resistance (Low Level)	初期: 50 mΩ 以下 試験後: 100 mΩ 以下 Initial: 50 mΩ Max. Final: 100 mΩ Max.	合格 Acceptable
2.3	絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 V DC 印加 1 分間印加 コネクタ嵌合なし 隣接コンタクト間で測定。100MΩ 以上 Impressed voltage 500 V DC. for 1 minute. Test between adjacent circuits of unmated connectors. 100MΩ Min.	合格 Acceptable
2.4	耐電圧 Dielectric withstanding Voltage	500 V AC 1 分間印加、コネクタ嵌合なし、隣接コンタクト間で 測定。 沿面放電、フラッシュオーバー等がないこと。 500 V AC for 1 minute. Test between adjacent circuits of unmated connectors. No creeping discharge or flashover shall occur.	合格 Acceptable
2.5	負荷電流と温度 Electrical load and Temperature	試験環境: 50°C以下、1000 時間、負荷電流; 0.8A、 金めっきの付いたダミーカードを使用する カード厚;0.76mm、接点部温度: 70°C以下 Temperature at contact-point shall not exceed 70°C Condition; 50°CMax. 1000hrs, Electrical load; 0.8A Use Au-plated dummy card. Card thickness; 0.76mm Temperature at contact-point shall not exceed 70°C	合格 Acceptable

Fig. 2 (続く) (to be continued)

2.6	温度上昇	定格電流を通電 接点部温度:70°C以下	合格
	Temperature rise	Under loaded specified current or rating current. Temperature at contact-point shall not exceed 70°C	Acceptable

機 械 的 性 能 Mechanicak Requirements

2.7	コネクタ挿入力	コンタクト接点変位量 0.29mmの時、 接圧 0.33N 以上、0.43N 以下	合格
	Contact Mating force	At Contact Point Stroke; 0.29mm Requirement; 0.33N Min., 0.43N Max.	Acceptable

2.8	振動 (定周波)	振動周波数: 10-500Hz 1oct./min. 振幅: 0.8mm 6G 振動方向: 3 方向 振動時間: 各 2 時間 振動中 0.4μsec. をこえる不連続導通を生じないこと。 物理的損傷のないこと。	合格
	Vibration (Sinusoidal)	Vibration Frequency: 10-500Hz / 0.8mm, 1oct./min. 6 G Vibration Direction: 3directions. Duration: 2 hours each No electrical discontinuity greater than 0.4μ second shall occur. No physical damage.	Acceptable

2.9	機械的操作 1	手挿抜にて 20 回挿抜、70°C レート; 10 サイクル/1 分 リカバリ時間; 2 時間 金めっきの付いたダミーカードを使用する。 カード厚さ; 0.76mm	合格
	Mechanical Operation 1	Operations shall be conducted manual at 70°C dry heat Operation cycles; 20, Rate; 10-cycle/1 minute. Recovery time; 2 hrs, Use Au-plated dummy card Card thickness; 0.76mm	Acceptable

2.10	機械的操作 2	手挿抜にて 20 回挿抜、-25°C レート; 10 サイクル/1 分 リカバリ時間; 2 時間 金めっきの付いたダミーカードを使用する。 カード厚さ; 0.76mm	合格
	Mechanical Operation 2	Operations shall be conducted manual at -25°C dry heat Operation cycles; 20, Rate; 10-cycle/1 minute. Recovery time; 2 hrs, Use Au-plated dummy card Card thickness; 0.76mm	Acceptable

2.11	機械的操作 3	実際の SIM カードを使用する。 挿抜回数; 750 回、10 サイクル/1 分、スピード; 10mm/s	合格
	Mechanical Operation 3	Test shall be conducted using real cards. Operation cycles; 750, Rate; 10-cycle/1 minute. Speed; 10 mm/s	Acceptable

2.12	機械的操作 4	実際の SIM カードを使用する。 挿抜回数; 5000 回、10 サイクル/1 分、スピード; 10mm/s	合格
	Mechanical Operation 4	Test shall be conducted using real cards. Operation cycles; 5000, Rate; 10-cycle/1 minute. Speed; 10 mm/s	Acceptable

Fig. 2 (続く) (to be continued)

2.13	衝撃 1	厚さ 0.68mm のダミーカードをコネクタに入れる。 6ms 連続、40G 半正弦波 衝撃回数 : 3 相互垂直方向それぞれに 10 回 振動中 0.4 μ sec. をこえる不連続導通を生じないこと。 物理的損傷のないこと。	合格
	Physical Shock 1	Slide 0.76mm thick dummy card in the connector. Subject test frame to 40G half sine shock pluses 6ms duration. Endurance; 10shocks in both directions of 3 mutual perpendicular axis. No electrical discontinuity greater than 0.4 μ second shall occur. No physical damage.	Acceptable
2.14	衝撃 2	厚さ 0.76mm \pm 0.08 の実際の SIM カードをコネクタに入れる。1ms 連続、500G 半正弦波、 衝撃回数 : 3 相互垂直方向それぞれに 2 回 物理的損傷のないこと。カードの抜けが無いこと	合格
	Physical Shock 2	Slide a real card of 0.76 \pm 0.08mm thick in the connector. Subject test frame to 500G half-sine shock pluses of 1 ms duration. Endurance; 2 shocks in both directions of 3 mutual perpendicular axis. No physical damage. Card shall not be ejected.	Acceptable
環 境 的 性 能 Environmental Requirements			
2.15	熱衝撃	-40°C / 30 分, 85°C / 30 分これを 1 サイクルとし 5 サイクル 行う。試験後 2 時間放置 厚さ 0.76mm の金めっき付きダミーカードを嵌合	合格
	Rapid change of temperature	-40°C / 30 min. , 85°C / 30 min. Making this a cycle, repeat 5cycles. Recovery time 2 hours. Use 0.76mm thickness Au-plated dummy card.	Acceptable
2.16	耐熱 1	温度; 70°C、期間; 16 時間、リカバリ時間; 2 時間 サンプル 1,2 はカード嵌合なし サンプル 3,4 は厚さ 0.76mm の金めっき付きダミーカードを嵌合	合格
	Dry heat 1	Temperature; 85°C, Duration: 240 hrs. Use Au-plated dummy card. Card thickness; 0.76mm	Acceptable
2.17	耐熱 2	温度; 85°C、期間 240 時間、 厚さ 0.76mm の金めっき付きダミーカードを嵌合	合格
	Dry heat 2	Temperature; 85°C, Duration: 240 hrs. Use Au-plated dummy card. Card thickness; 0.76mm	Acceptable
2.18	耐湿性 (定常状態)	温度; 40°C 湿度; 95 %R. H. 期間; 240 時間	合格
	Humidity (Steady State)	Temperature; 40°C, R.H. 95 % Duration: 240 hours	Acceptable

Fig. 2 (続く) (to be continued)

2.19	耐寒性	温度; -25°C 期間; 2 時間 リカバリー時間; 2 時間 厚さ 0.76mm の金めっき付きダミーカードを嵌合	合格
	Cold	Temperature; -25°C, Duration: 2 hrs. Recovery time; 2 hours, Use Au-plated dummy card. Card thickness; 0.76mm	Acceptable
2.20	はんだ付け性	コテ先温度 380°C、5 秒以内 外観異常の無きこと	合格
	Solderability	Soldering iron temperature 380°C, 5sec.Max No physical damage allowed.	Acceptable
2.21	はんだ耐熱性	108-78454 の図4-1, 4-2 に示すプロファイルにて IR リフロー槽で 2 回。 試験後物理的損傷を生じないこと。(クラック、かけ、溶け)	合格
	Resistance to Soldering Heat	2cycles of heat curve covering IR soldering curve specified 108-5998, figure 4-1, 4-2. No physical damage shall occur. (Cracks, chips or melting)	Acceptable
2.22	耐洗浄性	カード嵌合なし イソプロピルアルコール; 5 分間 擦らないこと	合格
	Cleaning liquid resistance	Unmated card. Isopropyl alcohol; 5minutes. Without rubbing.	Acceptable
2.23	工業ガス	SO ₂ ; 3mm ³ /m ³ 40±2°C、75% 時間; 48 時間 Sample1~2; 嵌合なし Sample3~4; 金めっき付きダミーカードを嵌合 Sample5~6; 実際の SIM カードを嵌合	合格
	Industrial atmosphere	SO ₂ ; 3mm ³ /m ³ 40±2°C、75% Humidity; 48 Hour. Sample1~2; Unmated Sample3~4; Mated Au-plated dummy card Sample5~6; Mated real card	Acceptable
2.24	コンタクト接圧	コンタクト接点変位量 0.29mm の時 接圧 0.33N 以上、0.43N 以下	合格
	Contact normal force	At Contact Point Stroke; 0.29mm Requirement; 0.33N Min. 0.43N Max.	Acceptable

Fig. 2 (終わり) (End)

3. 認定試験の試験順序

3. Product Qualification Test Sequence

		Fig. 3									
試験項目	Test Items	試験グループ/Test Group									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		試験順序/Test Sequence (a)									
製品の確認検査	Examination of Product	1,3,11,16,26	1,4,7,11	1,12	1,3	1,3	1,9	1,8	1,5		
接触抵抗	Termination Resistance	5,14,24	2,5,8,10	2,8			2,6	2,6			
絶縁抵抗	Insulation Resistance	6,13,22		3,10			3,7				
耐電圧	Voltage Proof	7,15,23		4,11			4,8				
負荷電流と温度	Electrical load & temperature			6							
温度上昇	Current cycling capacity				2						
コネクタ挿入力	Connector Mating force	4,25		5,9				3,7			
振動(定周波)	Vibration Sinusoidal	8									
機械的操作 1	Mechanical Operation 1	18									
機械的操作 2	Mechanical Operation 2	21									
機械的操作 3	Mechanical Operation 3		3,9								
機械的操作 4	Mechanical Operation 4							4			
衝撃 1	Physical Shock 1	9									
衝撃 2	Physical Shock 2	10									
熱衝撃	Thermal Shock 1	12									
耐熱 1	Dry Heat 1	17							3		
耐熱 2	Dry Heat 2			7							
耐湿性	Humidity	19						5			
耐寒性	Cold 1	20									
はんだ付け性	Solderability					2					
はんだ耐熱性	Resistance to Soldering Heat	2									
耐洗浄性	Cleaning liquid resistance						5				
工業ガス	Industrial atmosphere		6								
コンタクト接圧	Contact normal force								2,4		

(a)欄内の数字は試験の順序を示す。/Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

4. 試験結果

4. Test Results

試験項目 Test Item	単位 Unit	試験結果 Result				規格値 Spec.	判定 Judge- ment	
		N	Max.	Min.	Ave.			
試験グループ 1 Test Group 1								
製品の確認 Examination of Product	試験前 Before Test (試験順序 1 Test sequence 1)	-	5	製品の必要条件に合致 していた。 Met requirement of product drawing.			製品の必要条件に合致し ていること。 Meets requirement of product drawing.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 3 Test sequence 3)	-	5					合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 11 Test sequence 11)	-	5					合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 16 Test sequence 16)	-	5					合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 26 Test sequence 26)	-	5					合格 Accept- able
はんだ耐熱性 Resistance to Soldering Heat (試験順序 2, Test Sequence 2)	-	5	試験後物理的損傷を生 じなかった。 Physical damage didn't occur after test.			試験後物理的損傷を生じ ないこと。 No physical damage shall occur after test.	合格 Accept- able	
カード挿入力 Card Insertion Force	試験前 Before Test (試験順序 4 Test sequence 4)	N	5	5.1	4.3	4.8	50N 以下 50N Max.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 25 Test sequence 25)	N	5	4.3	3.9	4.1		合格 Accept- able

GROUP 1 (続く)(CONT.)

試験項目 Test Item		単位 Unit	試験結果 Result				規格値 Spec.	判定 Judge- ment
			N	Max.	Min.	Ave.		
接触抵抗 Termination Resistance	試験前 Before Test (試験順序 5 Test sequence 5)	mΩ	5	17.85	13.87	15.63	初期: 50 mΩ 以下 試験後: 100 mΩ 以下 Initial: 50 mΩ Max. Final: 100 mΩ Max.	合格 Accept- able
	試験前 Before Test (試験順序 14 Test sequence 14)	mΩ	5	17.20	13.51	15.55		合格 Accept- able
	試験前 Before Test (試験順序 24 Test sequence 24)	mΩ	5	17.32	13.92	15.71		合格 Accept- able
絶縁抵抗 Insulation Resistance	試験前 Before Test (試験順序 6 Test sequence6)	N	5	0.1x10 ¹² 以上		500 MΩ 以上 500 MΩ Min.	合格 Accept- able	
	試験後 After Test (試験順序 13 Test sequence 13)	N	5	0.1x10 ¹² 以上			合格 Accept- able	
	試験後 After Test (試験順序 22 Test sequence 22)	N	5	0.1x10 ¹² 以上			合格 Accept- able	
耐電圧 Voltage Proof	試験前 Before Test (試験順序 7 Test sequence7)	mΩ	5	沿面放電、フラッシュオ ーバー等は無かった。 The breakdown and flashover didn't occur.		沿面放電、フラッシュオー バー等が無いこと。 No breakdown or no flashover shall occur.	合格 Accept- able	
	試験後 After Test (試験順序 15 Test sequence 15)	mΩ	5	沿面放電、フラッシュオ ーバー等は無かった。 The breakdown and flashover didn't occur.			合格 Accept- able	
	試験前 Before Test (試験順序 23 Test sequence 23)	mΩ	5	沿面放電、フラッシュオ ーバー等は無かった。 The breakdown and flashover didn't occur.			合格 Accept- able	

GROUP 1 (続く)(CONT.)

試験項目 Test Item	単位 Unit	試験結果 Result			規格値 Spec.	判定 Judge- ment
		N	Max.	Min.		
振動(定周波) Vibration (Sinusoidal) (試験順序 8, test Sequence 8)	-	5	1μsec.を超える不連続導通、物理的損傷は無かった。 Electrical discontinuity greater than 1μsec. and physical damage didn't occur.		1μsec.を超える不連続導通、物理的損傷を生じないこと。 No electrical discontinuity greater than 1μsec. and physical damage shall occur.	合格 Acceptable
衝撃 1 Physical Shock 1 (試験順序 9, test Sequence 9)	-	5	1μsec.を超える不連続導通、物理的損傷は無かった。 Electrical discontinuity greater than 1μsec. and physical damage didn't occur.		1μsec.を超える不連続導通、物理的損傷を生じないこと。 No electrical discontinuity greater than 1μsec. and physical damage shall occur.	合格 Acceptable
衝撃 2 Physical Shock 2 (試験順序 10, test Sequence 10)	-	5	物理的損傷、カードの抜けは無かった。 Physical damage doesn't occur and Card didn't ejected.		物理的損傷、カードの抜けを生じないこと。 No electrical discontinuity greater than 1μsec. and physical damage shall occur.	合格 Acceptable
GROUP 1 (終了)/(END)						
試験グループ 2 Test Group 2						
製品の確認 Examination of Product	試験前 Before Test (試験順序 1 Test sequence 1)	-	5	製品の必要条件に合致していた。 Met requirement of product drawing.	製品の必要条件に合致していること。 Meets requirement of product drawing.	合格 Acceptable
	試験後 After Test (試験順序 4 Test sequence 4)	-	5			合格 Acceptable
	試験後 After Test (試験順序 7 Test sequence 7)	-	5			合格 Acceptable
	試験後 After Test (試験順序 11 Test sequence 11)	-	5			合格 Acceptable

GROUP 2 (続く)
(CONT.)

試験項目 Test Item		単位 Unit	試験結果 Result				規格値 Spec.	判定 Judge- ment
			N	Max.	Min.	Ave.		
接触抵抗 Termination Resistance	試験前 Before Test (試験順序 2 Test sequence 2)	mΩ	5	17.09	14.43	15.56	初期: 50 mΩ 以下 試験後: 100 mΩ 以下 Initial: 50 mΩ Max. Final: 100 mΩ Max.	合格 Accept- able
	試験前 Before Test (試験順序 5 Test sequence 5)	mΩ	5	16.76	12.30	15.25		合格 Accept- able
	試験前 Before Test (試験順序 8 Test sequence 8)	mΩ	5	19.01	13.32	15.88		合格 Accept- able
	試験前 Before Test (試験順序 10 Test sequence 10)	mΩ	5	18.85	13.23	15.72		合格 Accept- able

GROUP 2 (終了)

(END)

試験項目 Test Item	単位 Unit	試験結果 Result				規格値 Spec.	判定 Judge- ment	
		N	Max.	Min.	Ave.			
試験グループ 3 Test Group 3								
製品の確認 Examination of Product	試験前 Before Test (試験順序 1 Test sequence 1)	-	5	製品の必要条件に合致 していた。 Met requirement of product drawing.			製品の必要条件に合致し ていること。 Meets requirement of product drawing.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 12 Test sequence 12)	-	5					合格 Accept- able
接触抵抗 Termination Resistance	試験前 Before Test (試験順序 2 Test sequence 2)	mΩ	5	16.45	14.25	15.43	初期: 50 mΩ 以下 試験後: 100 mΩ 以下 Initial: 50 mΩ Max. Final: 100 mΩ Max.	合格 Accept- able
	試験前 Before Test (試験順序 8 Test sequence 8)	mΩ	5	18.18	14.64	15.85		合格 Accept- able
絶縁抵抗 Insulation Resistance	試験前 Before Test (試験順序 3 Test sequence3)	N	5	0.1x10 ¹² 以上			500 MΩ 以上 500 MΩ Min.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 10 Test sequence 10)	N	5	0.1x10 ¹² 以上				合格 Accept- able

GROUP 3 (続<)(CONT.)

試験項目 Test Item		単位 Unit	試験結果 Result				規格値 Spec.	判定 Judge- ment
			N	Max.	Min.	Ave.		
耐電圧 Voltage Proof	試験前 Before Test (試験順序 4 Test sequence4)	mΩ	5	沿面放電、フラッシュオーバー等は無かった。 The breakdown and flashover didn't occur.			沿面放電、フラッシュオーバー等が無いこと。 No breakdown or no flashover shall occur.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 11 Test sequence 11)	mΩ	5	沿面放電、フラッシュオーバー等は無かった。 The breakdown and flashover didn't occur.				合格 Accept- able
温度上昇 Electrical load and temperature (試験順序 6, test Sequence 6)		N	5	接触部温度は 70°Cを超えなかった。 Temperature at contact -point doesn't not exceed 70°C.			接触部温度が 70°C以下 Temperature at contact -point shall not exceed 70°C.	合格 Accept- able
カード挿入力 Card Insertion Force	試験前 Before Test (試験順序 5 Test sequence 5)	N	5	5.0	4.6	4.9	50N 以下 50N Max.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 9 Test sequence 9)	N	5	4.7	4.5	4.5		合格 Accept- able
GROUP 3 (終了)/(END)								
試験グループ 4 Test Group 4								
製品の確認 Examination of Product	試験前 Before Test (試験順序 1 Test sequence 1)	-	5	製品の必要条件に合致していた。 Met requirement of product drawing.			製品の必要条件に合致していること。 Meets requirement of product drawing.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 3 Test sequence 3)	-	5					合格 Accept- able

GROUP 4 (終了)/(END)

試験項目 Test Item		単位 Unit	試験結果 Result				規格値 Spec.	判定 Judgement
			N	Max.	Min.	Ave.		
試験グループ 5 Test Group 5								
製品の確認 Examination of Product	試験前 Before Test (試験順序 1 Test sequence 1)	-	5	製品の必要条件に合致していた。 Met requirement of product drawing.			製品の必要条件に合致していること。 Meets requirement of product drawing.	合格 Acceptable
	試験後 After Test (試験順序 3 Test sequence 3)	-	5					合格 Acceptable
はんだ付け性 Solder ability		-	5	95%以上ぬれていた。 Wet Solder Coverage over 95%.			95%以上ぬれていること Wet Solder Coverage is 95% Min.	合格 Acceptable
GROUP 5 (終了)(END)								
試験グループ 6 Test Group 6								
製品の確認 Examination of Product	試験前 Before Test (試験順序 1 Test sequence 1)	-	5	製品の必要条件に合致していた。 Met requirement of product drawing.			製品の必要条件に合致していること。 Meets requirement of product drawing.	合格 Acceptable
	試験後 After Test (試験順序 9 Test sequence 9)	-	5					合格 Acceptable
接触抵抗 Termination Resistance	試験前 Before Test (試験順序 2 Test sequence 2)	mΩ	5	16.94	14.31	15.28	初期: 50 mΩ 以下 試験後: 100 mΩ 以下 Initial: 50 mΩ Max. Final: 100 mΩ Max.	合格 Acceptable
	試験前 Before Test (試験順序 6 Test sequence 6)	mΩ	5	16.36	14.26	15.36		合格 Acceptable
絶縁抵抗 Insulation Resistance	試験前 Before Test (試験順序 3 Test sequence 3)	N	5	0.1x10 ¹² 以上			500 MΩ 以上 500 MΩ Min.	合格 Acceptable
	試験後 After Test (試験順序 7 Test sequence 7)	N	5					0.1x10 ¹² 以上

GROUP 6 (続<)(CONT.)

試験項目 Test Item		単位 Unit	試験結果 Result				規格値 Spec.	判定 Judge- ment
			N	Max.	Min.	Ave.		
耐電圧 Voltage Proof	試験前 Before Test (試験順序 4 Test sequence4)	mΩ	5	沿面放電、フラッシュオーバー等は無かった。 The breakdown and flashover didn't occur.			沿面放電、フラッシュオーバー等が無いこと。 No breakdown or no flashover shall occur.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 8 Test sequence8)	mΩ	5	沿面放電、フラッシュオーバー等は無かった。 The breakdown and flashover didn't occur.				合格 Accept- able
GROUP 6 (終了)(END)								
試験グループ 7 Test Group 7								
製品の確認 Examination of Product	試験前 Before Test (試験順序 1 Test sequence 1)	-	5	製品の必要条件に合致していた。 Met requirement of product drawing.			製品の必要条件に合致していること。 Meets requirement of product drawing.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 8 Test sequence 8)	-	5					合格 Accept- able
接触抵抗 Termination Resistance	試験前 Before Test (試験順序 2 Test sequence 2)	mΩ	5	16.83	14.19	15.24	初期: 50 mΩ 以下 試験後: 100 mΩ 以下 Initial: 50 mΩ Max. Final: 100 mΩ Max.	合格 Accept- able
	試験前 Before Test (試験順序 6 Test sequence 6)	mΩ	5	17.11	12.61	15.35		合格 Accept- able
カード挿入力 Card Insertion Force	試験前 Before Test (試験順序 3 Test sequence 3)	N	5	5.3	4.7	5.0	50N 以下 50N Max.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 7 Test sequence 7)	N	5	4.7	4.5	4.6		合格 Accept- able

GROUP 7 (終了)(END)

試験項目 Test Item	単位 Unit	試験結果 Result				規格値 Spec.	判定 Judge- ment	
		N	Max.	Min.	Ave.			
試験グループ 8 Test Group 8								
製品の確認 Examination of Product	試験前 Before Test (試験順序 1 Test sequence 1)	-	5	製品の必要条件に合致 していた。 Met requirement of product drawing.			製品の必要条件に合致し ていること。 Meets requirement of product drawing.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 5 Test sequence 5)	-	5					合格 Accept- able
コンタクト 接圧 Contact Normal Force	試験前 Before Test (試験順序 2 Test sequence 2)	N	5	0.40	0.37	0.38	コンタクト接点変位量 0.29 mmの時、 接圧 0.33N 以上 0.43N 以下 At Contact Point Stroke; 0.29mm Requirement; 0.33N Min., 0.43N Max.	合格 Accept- able
	試験後 After Test (試験順序 4 Test sequence 4)	N	5	0.39	0.36	0.38		合格 Accept- able

GROUP 8 (続く)(CONT.)